



LOTPASTE SC BLF08

Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF 08** ist eine Weiterentwicklung im Hinblick auf alle sogenannten **bleifreien SMT-Anwendungen** und dem Kundenwunsch nach einer leichter druckbaren und länger „klebrigen“ Paste. Insbesondere die Verwendung von modifizierten Kunststoffen und -harzen, Aktivatorensystemen etc. in unseren bisherigen Lotpasten und die daraus resultierende, sehr gute Kombinationsmöglichkeit mit bleifreien Legierungen, sowie die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen beim „Bleifreilöten“ haben zu dieser Weiterentwicklung beigetragen. Eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde. Die **BLF 08** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien Lotpulver**, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunstharzbasis**, das der Kl. RE L0 nach DIN EN61190-1-1 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Die üblichen Vorteile, wie die hervorragende Konturenstabilität, keine Lotkugel- oder Spritzerbildung, sowie hohe Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste, neben einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und stark verlängerten Standzeit, folgende Vorteile aus:

- * **BLF 08*** Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Sehr lange Klebrigkeit!!!
- * **BLF 08*** Bildet sehr homogene, lunkerfreie Lötstellen!
- * **BLF 08*** Lötet problemlos, auch auf leicht korrodierten Oberflächen.
- * **BLF 08*** Die Rückstände entsprechen zudem der RO L0 Klassifizierung!
- * **BLF 08*** Eine hervorragende, stundenlange Druckqualität, wie bereits gewohnt!
- * **BLF 08*** Hinterlässt natürlich keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- * **BLF 08*** Die Rückstände betragen nur 5,8% bei 89% Metallgehalt.

PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	Schmelzpunkt	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:	
Sn98,5/Ag1/Cu0,5	221 - 227°C		
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217 - 219°C	Kl.3	25 - 45 µm
Sn96,9/Ag2,6/Cu0,5	217 - 221°C	Kl.4	20 - 38 µm
Sn96,5/Ag3,5	221°C	Kl.5	10 - 25 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C		

VISKOSITÄT (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT–DV II Viskosimeter mit 89% Metallgehalt:

<u>Viskosität:</u> *		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
		Sofort	20min 80°C		
600 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
650 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messung am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	3,5 x 10 ¹¹	2,7 x 10 ¹¹

